

Fibocom lance le module 5G FM350 en partenariat avec Intel et MediaTek pour inspirer de nouvelles solutions 5G compatibles sur PC

Fibocom (symbole boursier : 300638), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions IdO (Internet des objets) sans fil et de modules de communication sans fil, annonce aujourd'hui la sortie conjointe du module sans fil 5G FM350. En partenariat avec Intel et MediaTek, le FM350 de Fibocom est conçu pour offrir une connectivité sans fil 5G à haut débit pour une meilleure prise en charge des plateformes sur PC et une meilleure expérience utilisateur.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : <https://www.businesswire.com/news/home/20210628005851/fr/>

Inspire New 5G Solutions for PC (Photo: Fibocom)



Basé sur la plateforme du chipset MediaTek T700, le module FM350 de Fibocom prend en charge la bande 5G NR Sub-6 atteignant théoriquement jusqu'à 4,67 Gbps en liaison descendante et 1,25 Gbps en liaison montante.

Prenant en charge les architectures de système autonome (SA) et non autonome (NSA) 5G, le module 5G FM350 de Fibocom est rétrocompatible avec les normes de réseau LTE/WCDMA, ce qui permet d'alléger la complexité de la configuration du produit final.

Le module FM350 de Fibocom est parfaitement adapté aux PC (ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes, etc.), et prend en charge les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Chrome. Conçu avec le facteur de format standard M.2, le module dispose de plusieurs interfaces,

notamment PCIe 3.0, USIM, I2C, Body SAR, MIPI Tuner, d'une antenne accordable, etc., libérant le potentiel de la technologie cellulaire pour satisfaire la demande d'applications à large bande passante. En outre, le FM350 est doté d'une SIM embarquée intégrée, qui offre aux utilisateurs finaux la possibilité de sélectionner des profils d'opérateurs. Il prend également en charge la GNSS, notamment les systèmes GPS, GLONASS, BeiDou et Galileo.

Le module FM350 de Fibocom est certifié mondialement par des organismes de réglementation régionaux, d'opérateurs grand public et des institutions du secteur industriel, et a obtenu l'approbation de plusieurs laboratoires de certification technique.

« Nous sommes enthousiasmés à l'idée de nous associer à Intel et MediaTek pour proposer une nouvelle génération de solution 5G sur PC. Basé sur le chipset MediaTek T700, le module 5G FM350 de Fibocom représente une belle avancée dans la prolifération pour la 5G sur PC, permettant aux utilisateurs de se connecter de manière transparente aux réseaux 5G du monde entier. Ce module est un excellent complément pour notre famille de modules sans fil 5G, qui offre une expérience PC sécurisée et à large bande passante fournie par la technologie 5G », a déclaré Tiger Ying, CEO de Fibocom.

« Intel se met en quatre pour offrir la meilleure expérience possible sur l'ensemble de ses plateformes informatiques mobiles. Avec un accès sans fil tout le temps et partout (lorsqu'elles sont disponibles), la technologie 5G permet aux utilisateurs de PC connectés modernes de rester productifs et de profiter d'applications de nouvelle génération. ¹ Nous sommes enchantés de collaborer avec Fibocom et MediaTek en lançant la nouvelle solution Intel® 5G 5000. Ensemble, nous fournissons des capacités 5G de pointe pour nos dernières plateformes mobiles Intel® Core™ de 11e génération », a déclaré Eric A. McLaughlin, vice-président de Client Computing Group & GM Wireless Solutions Group, Intel Corporation.

« Le T700 de MediaTek amène à repenser la prochaine génération d'expériences sur PC. Grâce à notre technologie révolutionnaire de modem 5G, le nouveau module offrira aux consommateurs du monde entier des expériences connectées à des vitesses de données inégalées, libérant ainsi un plus grand potentiel de productivité, de jeu et même de divertissement, que les utilisateurs se trouvent à la maison ou en déplacement », a déclaré le Dr JC Hsu, vice-président et directeur général de l'Unité commerciale de communications sans fil de MediaTek. « Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec Intel et Fibocom pour faire bénéficier les consommateurs du monde entier des dernières technologies 5G ».

À propos de Fibocom

Fibocom est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de modules et de solutions de communication sans fil dans le secteur de l'IdO (Internet des objets), ainsi que le premier fournisseur de modules sans fil coté en bourse en Chine (symbole boursier : 300638). Nous fournissons des solutions de communication sans fil IdO de bout en bout aux opérateurs de télécommunications, aux fabricants d'équipements IdO et aux intégrateurs de systèmes IdO. Forts de plus de deux décennies d'engagement dans la technologie de communication M2M et IdO et d'une vaste expertise, nous sommes capables de développer en toute indépendance des modules de communication sans fil de haute performance, notamment 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, Android Smart, Automotive, WCDMA/HSPA(+), GSM/GPRS, Wi-Fi, GNSS, etc. Outre des solutions de

communication IdO fiables, pratiques, sûres et intelligentes pour la quasi totalité des industries verticales, nous nous sommes également adaptés pour personnaliser les meilleurs modules et solutions IdO offrant un rendement optimal, et satisfaire ainsi vos besoins spécifiques.

¹ Pour de plus amples information, rendez-vous sur le site www.intel.com/PerformanceIndex (connectivité)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.



Consultez la version source sur businesswire.com :
<https://www.businesswire.com/news/home/20210628005851/fr/>